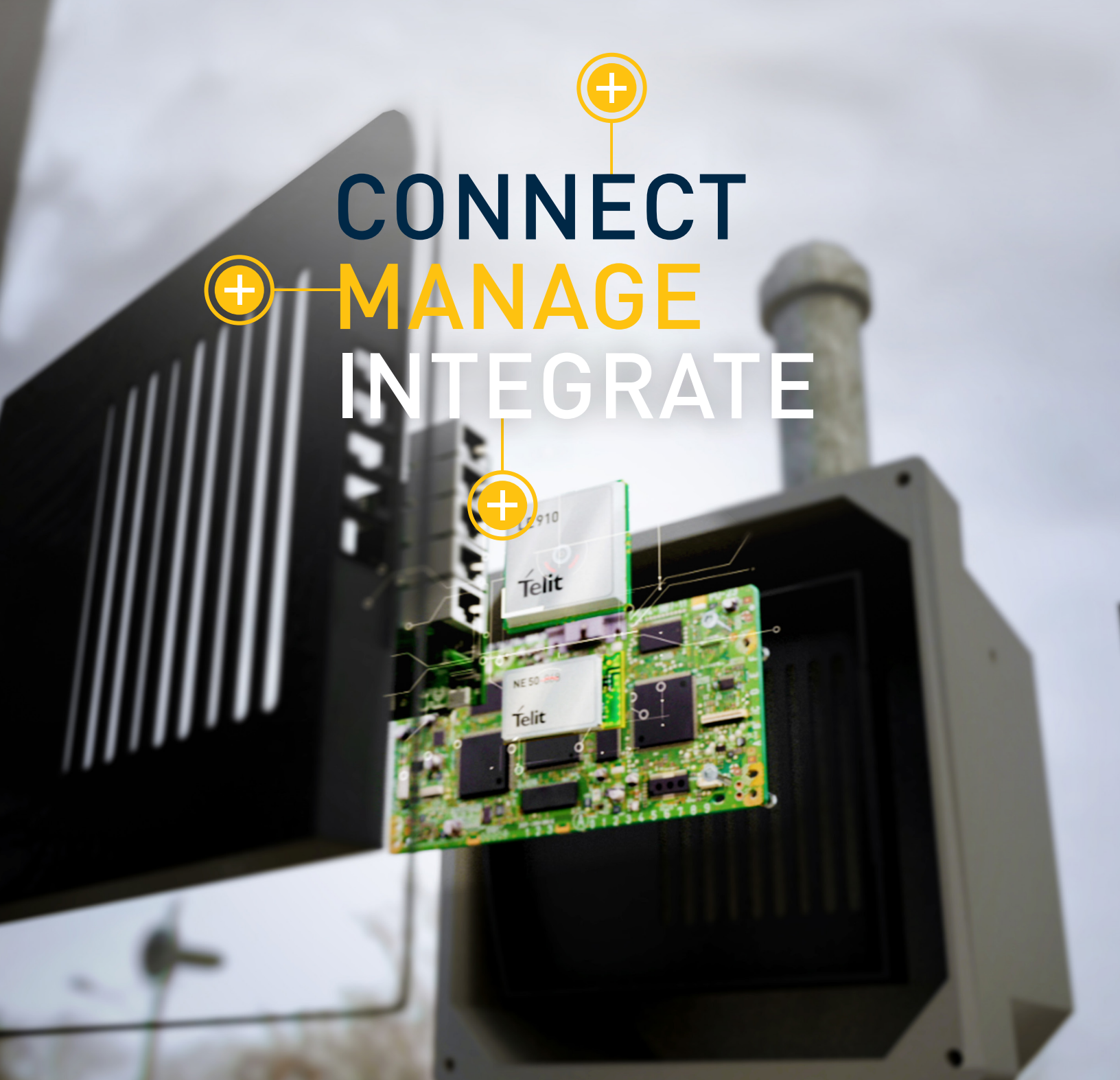




CONNECT
MANAGE
INTEGRATE

The background image shows an industrial setting with a large grey metal structure and a chimney. Overlaid on this is a green printed circuit board (PCB) representing a Telit IoT module. The PCB has two white modules labeled 'Telit' and 'NE 50 545'. Three yellow circular icons with a plus sign are connected to the text 'CONNECT', 'MANAGE', and 'INTEGRATE' by thin yellow lines.

IoT PRODUCT SELECTION GUIDE



[illegible]

[illegible]

PRODUCT FAMILY		GENERATION	TECHNOLOGY	FORM FACTOR	PRODUCT	APPROVALS										AVAILABLE FOR				BANDS		TECHNOLOGY	DATA SPEED (UL/DL)		INTERFACES				FEATURES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CELLULAR MODULES & TERMINALS					Picture – Backside *Terminal Family Front-/Backside	R&TTE CE GCF PTCRB FCC IC KCC CDG1 & 2 (CCF) CCC ANATEL A-TICK (RCM) Radio/Telecom Biz Act EMEA LATIN AMERICA NORTH AMERICA APAC AUSTRALIA AFRICA RUSSIA KOREA	Bands		Cellular Technology	2G (GSM GPRS) Kbps 2.75G (EDGE) Kbps 3G (UMTS) Kbps 3.5G (HSDPA) Mbps 3.75G (HSPA+) Mbps CDMA (1xRTT) Kbps 4G (LTE) Mbps	USB type	AAI (analog audio interface) DVI (digital voice interface) DAC (digital to analog converter) ADC (analog to digital converter) GPIO (general purpose input/output) CAN (Automotive bus) Ethernet (100MB, no PHY)	Size (mm)	Surface mounting	Antenna connector	Temperature Range	GNSS channels Embedded TCP/IP Stack SIM Access Profile AppZone C AppZone Python Java Designed for Automotive Applications Ready for e-Call/ERA GLONASS Jamming Detection Bundling Event Monitor SIM on CHIP IoT Portal - API IoT LOCATE Secure Element (SmartCard CPU TSM Wi-Fi support																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
xE864 Family	2G	GSM GPRS	Embedded	GE864 Series		•••••		•••••	2G (GSM GPRS)	2G 40/80	•••••	30 x 30 x 2.8	BGA	RF PAD	-40°C to +85°C	48•••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••

IoT MODULE SERVICES

TELIT IoT APPZONE

Accelerate innovation using framework and tools to access the full power of the IoT module.

IoT AppZone simplifies the design of your products and using Telit IoT Services allows you to manage the full lifecycle of your applications and software components.

Rely on powerful development tools, professional grade framework and APIs, built in IoT cloud services support.

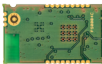
TSM – TELIT SOFTWARE MANAGEMENT

Telit Software Management is a premium service enabling Telit customers to OTA manage their device software.

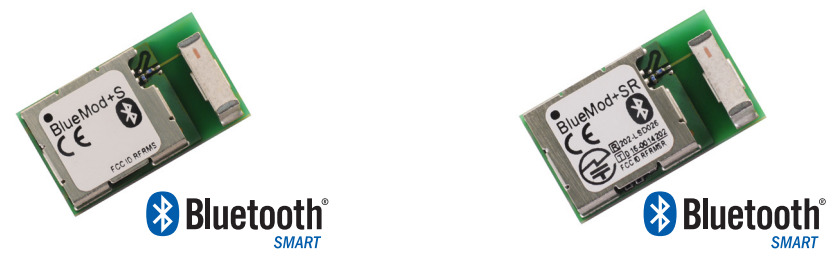
Over the air firmware update service supports all previous generations of Telit modules and new 3G and 4G platforms.

New Telit Software Management OMA DM based solution enables customers to manage on-module and off-module applications in addition to module firmware.

TECHNOLOGY		PRODUCT			POWER SUPPLY					ENVIRONMENTAL					POSITIONING										SENSITIVITY			INTERFACES										
RADIO TECHNOLOGY	FORM FACTOR	GNSS MODULES GPS MODULES	Picture – Back side	Chip Solution	Supply range (Volt)	Acquisition Mode (mW)	Navigation Mode (mW)	Low Power Navigation Mode (mW)	Hibernate mode (µW)	Size (mm)	Surface mounting	Pin, Balls, Pads	Antenna connector	Temperature Range	GPS	QZSS	Glonass	Galileo (Ready)	Beidou	SBAS	RTCM	A-GPS	Jammer Rejection	Flash Memory (For full FW upgrades)	Patch and AGPS Storage Memory	Dead Reckoning	Timing	Acquisition (dBm)	Navigation (dBm)	Tracking (dBm)	UART	USB	SPI	I2C	CAN Bus	GPIO	R&TTE and CE	
GPS		JUPITER SE880		SiRF 4	1.75 - 1.90	82	63	18	25	4.7 x 4.7 x 1.4	●	32		-40°C to +85°C	●	●				●		●	●					-148	-163	-165	●		●	●		●	●	
		JUPITER JF2		SiRF 4	1.75 - 1.90	82	63	18	25	11 x 11 x 2.4	●	32			●	●				●		●	●	○	○			-147	-160	-163	●		●	●		●	●	
		JUPITER JN3		SiRF 4	2.85 - 3.60	151	105	-	120	16 x 12.2 x 2.4	●	24			●	●				●		●	●	○	○			-147	-160	-163	●						●	
		JUPITER SE868-AS		MT3337	2.80 - 4.30	54	54	15	20	11 x 11 x 6.1	●	32			●	●				●		●	●					-148	-163	-165	●						●	
		JUPITER SL869 V2S		MT3337	3.00 - 3.60	81	79	15	20	16 x 12.2 x 2.4	●	24			●	●				●		●	●					-148	-163	-165	●						●	
		JUPITER SL871-S		MT3337	2.80 - 4.30	51	43	15	20	10.1 x 9.7 x 2.4	●	18			●	●				●		●	●					-148	-163	-165	●						●	
GNSS	Embedded	JUPITER SE873		SiRF 5 (B02)	1.75 - 1.85	101	70	20	62	7 x 7 x 1.85	●	20		-40°C to +85°C	●	●	●	●	●	●		●	●	●				-148	-163	-166	●		●	●		●	●	
		JUPITER SE871		MT3333	2.80 - 4.30	72	66	21	21	10.1 x 9.7 x 2.4	●	18			●	●	●	●	●	●	●	●				-148	-163	-165	●			●		●	●			
		JUPITER SE868 V3		SiRF 5 (B02)	1.75 - 1.90	75	68	20	45	11 x 11 x 2.4	●	32			●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			-148	-163	-166	●		●	●		●	●	
		JUPITER SE868-A		MT3333	2.80 - 4.30	84	72	21	21	11 x 11 x 6.1	●	24			●	●	●	●		●	●	●	●	●			-148	-163	-165	●					●	●		
		JUPITER SL869		ST Teseo 2	3.00 - 3.60	234	138	69	219	16 x 12.2 x 2.4	●	24			●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●	-146	-158	-162	●	●		●	●	●	●
		JUPITER SL869 V2		MT3333	3.00 - 3.60	115	89	21	21	16 x 12.2 x 2.4	●	24			●	●	●	●	●	●	●	●			-148	-163	-165	●				○		●				
		JUPITER SC872-A		MT3333	3.30 - 5.00	90	78	15	21	21 x 22 x 8.5		4		-30°C to +70°C	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			-148	-163	-165	●						●	
		JUPITER SL869-3DR		ST Teseo 3	3 - 3.6	234	140			16 x1 2,2 x 2,4	●	24		-40°C to +85°C	●	●	●	●	●	●	●	●			●		-148	-160	-162	●			●		●			
		JUPITER SL869-V3		ST Teseo 3	3 - 3.6	234	140			16 x1 2,2 x 2,4	●	24		-40°C to +85°C	●	●	●	●	●	●	●	●			●		-148	-160	-162	●			●		●			

TECHNOLOGY			PRODUCT		FAMILY FORM FACTOR	FREQUENCY	RANGE	EMBEDDED STACK	DATASPEED	POWER SUPPLY		ENVIRONMENTAL	
RADIO TECHNOLOGY	TECHNOLOGY Short Range	FORM FACTOR	SHORT to LONG RANGE RF PRODUCTS	Picture – Back side	FAMILY FORM FACTOR	Frequency	Range	Embedded Stack Option	Radio Data Rate	Idle power saving	Output Power	Size (mm)	Antenna connector
Short to Long Range RF	Star Network	Embedded	LE 50-433 / 868		xE RF modules	433 MHz / 868 MHz	up to 2000 m	Star	9.6 to 115.2 Kbps / 4.8 to 115.2 Kbps	1µA	25 mW	26 x 15 x 3	RF pad
	SigFOX Star Network		LE 51-868 S			863 MHz - 870 MHz	up to 2000 m up to 40 km	Star + repeater mode Sigfox gateway	2.4 Kbps to 115.2 Kbps 100 bps	1.5 µA	35 mW		
	Star Network		LE 70-868 / 915			868 MHz / 915 MHz	up to 10 km	Star	4.8 to 57.6 Kbps / 9.6 to 57.6 Kbps	1µA	500 mW		
	Wireless M-Bus EN13757		ME 50-868			868 MHz	2000 m	Wireless M-Bus	4.8 to 100 Kbps	1µA	25 mW		
			ME 70-169	169 MHz		20 km	Wireless M-Bus	2.4 to 19.2 Kbps	1.5 µA	up to 1 W			
	IEEE 802.15.4 / Zig-bee®		ZE 51 / ZE 61-2.4			2400 MHz	1000 m / 4000 m	Zigbee® Pro	250 Kbps	1µA	2.5 mW / 100 mW		RF pad

BLUETOOTH® MODULES



PRODUCT	BLUEMOD+SR	BLUEMOD+S
Supported profiles	SPP, GATT, Terminal I/O	Terminal I/O GATT Central and Peripheral Automation I/O, SCIS
Dimensions (mm)	10 x 17 x 2.6	10 x 17 x 2.6
Bluetooth qualification	V4.0	V4.1
Certification	CE, FCC, IC, KCC, MIC	CE, FCC, IC, KCC
RF-Power (max)	-23 to +8 dBm	-30 to +5 dBm
Range (open air, line of sight)	Up to 100 m	Up to 50 m
Antenna, internal	Ceramic	Ceramic
Access antenna external	Pin	n/a
Serial	9.6-921 kbps	9.6-921 kbps
Pins	LGA	LGA
Temperature range	-30°C to +85°C	-25°C to +75°C
Power supply	2.5V – 3.6V	1.8V - 3.6V
Power consumption transmission	15-27 mA (depending on connection parameters)	2 – 6 mA (depending on connection parameters)
Power consumption idle	SPP: 0.75 mA Terminal I/O: 0.25 mA	0.021 mA
Power consumption deep sleep	0.15 mA	0.003 mA
Evaluation and Development Kits	BlueEva+SR	BlueEva+S, BlueEva+S/ADC, BlueEva+S/Central BlueDev+S with A NT support



IoT INNOVATION

DRIVING BUSINESS TRANSFORMATION TOGETHER TODAY!

Telit is the partner

to help you create IoT enabled solutions and applications, with complete lifecycle management in all market segments and functions



IoT MODULES



IoT CONNECTIVITY



IoT PLATFORM

Together, our offerings in these three essential areas of application enablement deliver so much business breakthrough power, we call it the **Telit IoT Engine**



www.telit.com